

연수 제안서

연구 분야	소프트 전자시스템, 소프트 로봇, 마이크로로봇
연구 과제명	자성복합소재 기반 소프트 전자시스템 및 로봇 기술 개발
연수 제안 업무	- 자기조립 기반 첨단 자성복합소재 및 고분자 개발 - 자성 소재 기반 지능형 소프트 전자소자 및 시스템 개발 - 자성 소재 기반 지능형 소프트 로봇 및 마이크로로봇 기술 개발
<p>○ 연수 기간 : 2024. 01. ~ 2024. 12.</p> <p>○ 연구 내용</p> <p>1. 목표</p> <p>: 형상 변형이 가능한 자성복합소재 기반 지능형 소프트 전자시스템을 개발하고 이를 통해 첨단 소프트 로봇 및 생체의료용 마이크로로봇 원천기술을 개발함.</p> <p>2. 연구 내용 및 방법</p> <p>: 자기조립 기반 자성 유연복합소재 및 고분자 개발</p> <p>: 자성복합소재 기반 지능형 소프트 전자소자 및 시스템 개발</p> <p>: 자성복합소재 기반 지능형 소프트 로봇 및 마이크로로봇 기술 개발</p> <p>3. 모집 분야</p> <p>: 소프트 전자, 소프트 로봇, 또는 생체의료용 마이크로로봇 분야 연구 경험자</p> <p>: 신소재/기계/전기전자 전공 박사학위 소지자 및 취득 예정자</p> <p>: 상호 협의 하에 연수 기간 연장 가능</p>	
소속 부 서 : 소프트융합소재연구센터	
연수 책임자 : 변 정 환	